



半导体产业链景气度结构性攀升， Agentic AI带动CP价值重估

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年03月10日

- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

研究创造价值

AI算力需求旺盛带动半导体产业链景气度结构性攀升

进入2026年，半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件，从晶圆代工到封测环节，全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等，佰维存储等龙头企业盈利的大幅提升印证着行业的强势回暖。然而，本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元，高带宽内存（HBM）与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准，却也同时暴露了传统消费电子与工业芯片需求的复苏乏力。中芯国际93.5%的产能利用率与蓝箭电子等分立器件企业的毛利承压形成对比，约半数芯片公司仍在亏损线上挣扎的事实映射出这不是一次普惠式的行业复苏，而是一场以AI为核心的局部景气度攀升。

Agentic AI带动CPU价值重估，AI算力芯片国产化趋势延续

AI Agent时代正在重估CPU价值。人工智能正从回答问题的大模型（LLM）迈向自主行动的智能体，这一范式转移彻底重构了算力供需格局——CPU从被视为理所当然的基础设施底座，跃升为决定AI响应速度和成本的前线关键。Agent时代CPU承担三大核心任务：一是驱动沙箱VM作为Agent的“数字身体”，执行文件I/O、代码解释、进程隔离等密集型任务；二是支撑高并发与长在线特性（会话从分钟级进入小时级，并发需求指数级增长）；三是在存算分离架构中充第二显存”，承担检索、筛选和数据转发。研究显示，在典型Agent任务中CPU处理占总延迟的90%以上，能耗占比与GPU平分秋色，成为新的性能瓶颈。目前，市场已现CPU缺货潮。Intel、AMD服务器CPU交货周期拉长至8-10周甚至6个月。NVIDIA已追加20亿美元投资Core Weave，大规模部署自研Arm架构CPU以应对Agent负载。

建议关注：天数智芯、芯原股份、海光信息、中芯国际、华虹公司。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026/3/6 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
688981.SH	中芯国际	106.5	0.46	0.63	0.77	231.52	169.05	137.76	买入
688347.SH	华虹公司	117.79	0.22	0.32	0.64	535.41	368.55	182.88	未评级
9903.HK	天数智芯	259.6	-5.89	-3.98	-1.78	-44.07	-65.23	-145.84	买入
688041.SH	海光信息	241.9	0.83	1.09	2	291.45	221.93	120.93	买入
688521.SH	芯原股份	240.85	-1.2	-1	0.33	-200.71	-240.85	741.08	增持

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期，港股股价和EPS货币单位为港元）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

3月2日-3月6日当周，海外龙头总体呈下跌态势。其中，博通领涨，涨幅为3.42%，拉姆研究跌幅为-14.67%。
 图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

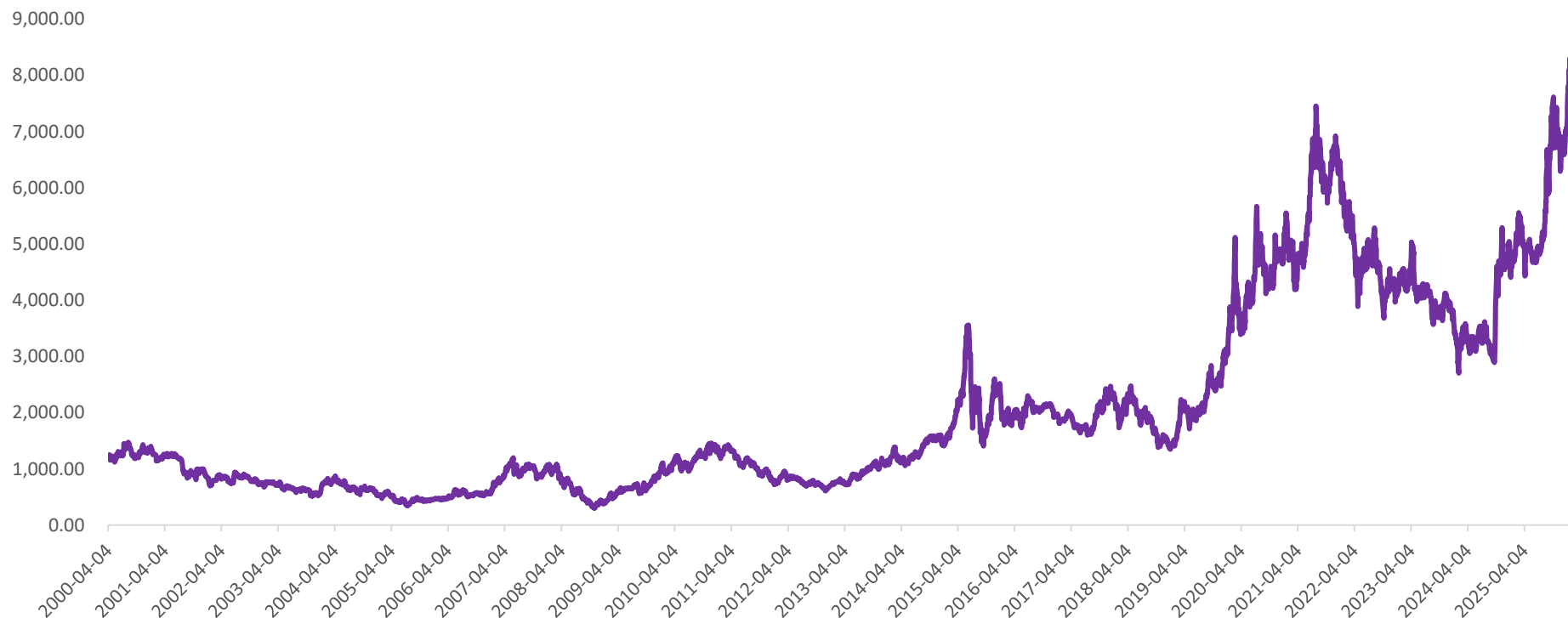
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值（亿元）	PE (LYR)	PB (MRQ)	周涨跌幅（%）
处理器	INTC.0	英特尔 (INTEL)	美国	2168.83	-812.30	1.90	-4.80
	QCOM.0	高通 (QUALCOMM)	美国	1447.81	26.13	6.27	-4.07
	AMD.0	超威半导体 (AMD)	美国	3137.40	72.37	4.98	-3.89
	NVDA.0	英伟达 (NVIDIA)	美国	43210.26	35.99	27.47	0.36
存储	MU.0	美光科技 (MICRON TECHNOLOGY)	美国	4167.76	48.81	7.09	-10.20
模拟	TXN.0	德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1759.29	35.38	10.81	-8.90
	ADI.0	亚德诺 (ANALOG)	美国	1541.80	68.00	4.56	-10.96
	AVGO.0	博通 (BROADCOM)	美国	15650.22	67.67	19.59	3.42
	NXPI.0	恩智浦半导体 (NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	509.78	25.22	5.07	-11.13
射频	SWKS.0	思佳讯 (SKYWORKS)	美国	82.42	17.28	1.43	-8.01
	QRVO.0	QORVO	美国	71.94	129.35	1.95	-6.34
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	278.72	167.90	1.56	-6.69
	ON.0	安森美半导体 (ON SEMICONDUCTOR)	美国	224.08	185.19	2.92	-14.46
光学	IFX.DF	英飞凌科技	德国	512.13	50.46	2.94	-13.98
	3008.TW	大立光	中国台湾	3176.54	14.93	1.68	-5.56
半导体设备	AMAT.0	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	2577.17	36.83	11.87	-12.77
	LRCX.0	拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	2489.18	46.46	24.53	-14.67
	KLAC.0	科天半导体 (KLA)	美国	1762.39	43.39	32.24	-11.81
	ASML.0	阿斯麦	荷兰	5091.44	45.22	22.16	-10.88
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2232.79	22.68	2.49	2.64
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	557807.30	28.53	9.04	-5.26
	GFS.0	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	260.60	29.45	2.18	-1.41
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1265.46	164.75	3.21	-11.69
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	466.38	46.30	4.47	-13.05
分销	ARW.N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	70.68	12.37	1.07	-9.07
	AVT.0	安富利 (AVNET)	美国	49.16	20.46	1.00	-8.29

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

3月2日-3月6日当周，申万半导体指数整体呈现震荡下行的态势。3月6日，申万半导体指数为7640.65，周跌幅为-5.57%。

图表3：近5年申万半导体指数

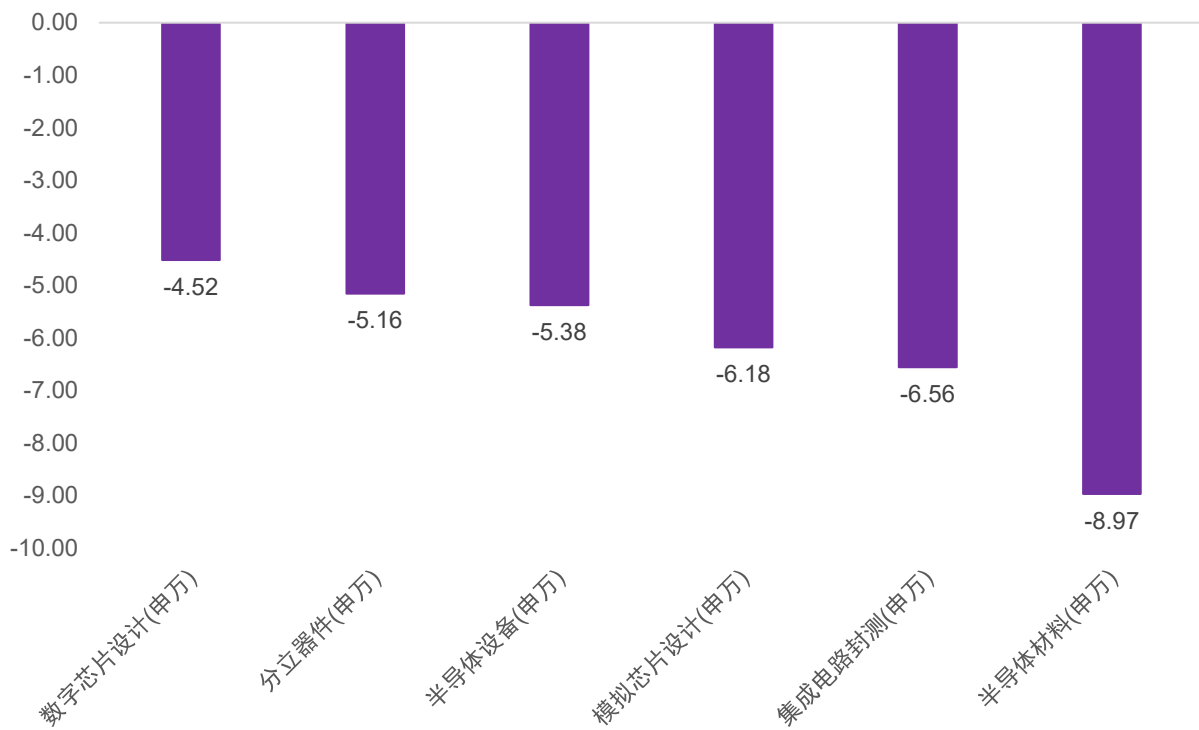


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

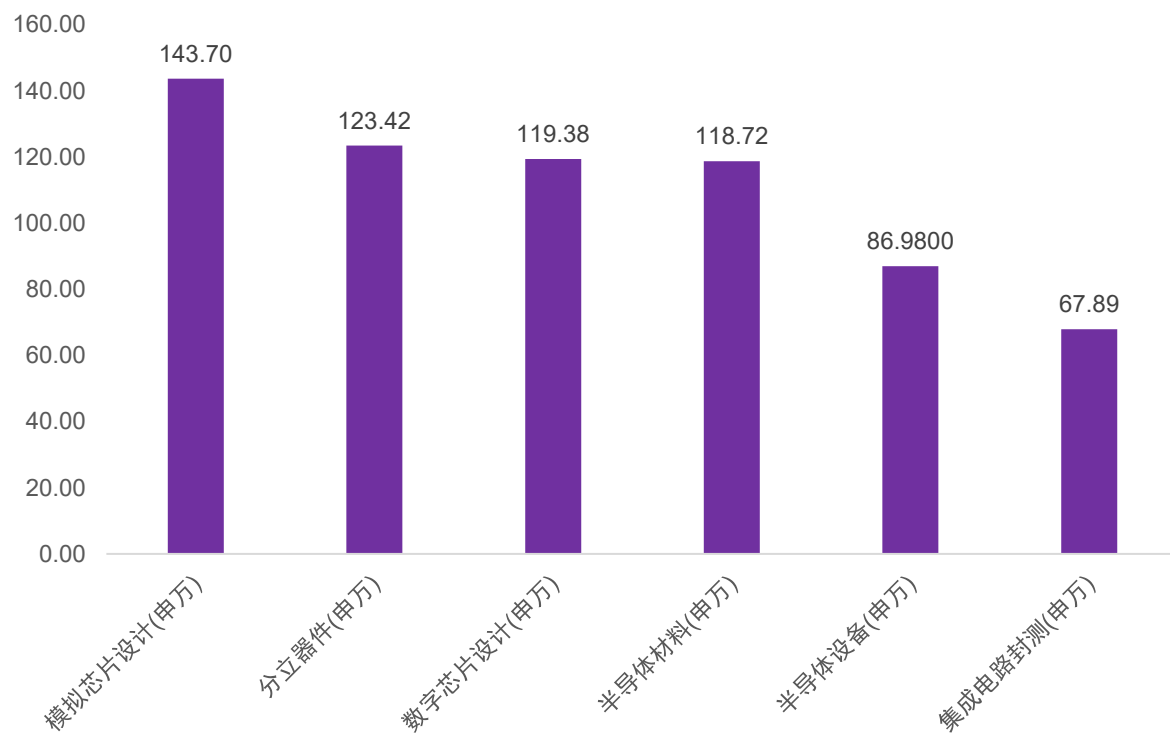
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，3月2日-3月6日当周，半导体细分板块呈下跌态势。其中，半导体材料板块跌幅最大，达到8.97%；数字芯片设计板块跌幅最小，达到4.52%。估值方面，模拟芯片设计，分立器件，数字芯片设计板块估值水平位列前三。

图表4：3月2日-3月6日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：3月6日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

电子化学品板块主力净流入6.72亿元，主力净流入率为0.59%，在9个二级子行业中排第1名；其他电子板块主力净流出11.15亿元，主力净流入率为-1.36%，在9个子行业中排第9名。

图表6：3月2日-3月6日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW电子化学品II	4,122,550.25	4,055,333.56	67,216.69	0.59	-1
SW其他电源设备II	3,772,372.57	3,739,320.30	33,052.28	0.31	2
SW半导体	36,627,378.94	36,964,760.11	-337,381.17	-0.37	-3
SW消费电子	12,519,690.82	12,776,151.48	-256,460.67	-0.81	-4
SW通信设备	27,857,134.96	28,490,852.41	-633,717.45	-1.03	-1
SW计算机设备	4,746,906.08	4,919,730.55	-172,824.47	-1.18	1
SW军工电子II	7,018,822.92	7,259,179.20	-240,356.27	-1.23	-2
SW航天装备II	2,228,012.39	2,323,157.62	-95,145.23	-1.25	-1
SW其他电子II	3,006,687.29	3,118,202.77	-111,515.49	-1.36	-1

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

3月2日-3月6日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：派瑞股份，佰维存储，源杰科技，德明利，江波龙，盛科通信-U，东芯股份，卓胜微，拓荆科技，至正股份，周涨幅分别为：38.17%，26.25%，10.52%，5.93%，4.90%，3.20%，3.09%，2.53%，2.11%，1.97%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值（亿元）	EPS			PE			PB	周涨跌幅（%）
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
300831.SZ	派瑞股份	67.30	0.22	-	-	94.45	-	-	7.34	38.17
688525.SH	佰维存储	977.85	0.37	1.92	4.16	723.02	-	-	21.37	26.25
688498.SH	源杰科技	731.33	-0.07	1.34	2.02	-11922.79	635.94	420.30	31.36	10.52
001309.SZ	德明利	615.02	2.36	3.15	4.57	175.36	120.59	83.22	18.81	5.93
301308.SZ	江波龙	1282.58	1.20	1.24	6.94	253.86	250.02	44.09	17.04	4.90
688702.SH	盛科通信-U	833.74	-0.17	-0.06	0.13	-1221.33	-3334.94	1543.95	37.36	3.20
688110.SH	东芯股份	638.30	-0.38	1.23	-0.11	-364.28	116.90	-1329.79	18.67	3.09
300782.SZ	卓胜微	439.83	0.75	3.45	0.71	109.24	23.89	115.12	4.39	2.53
688072.SH	拓荆科技	1065.00	2.47	3.84	5.06	154.93	99.63	75.53	17.31	2.11
603991.SH	至正股份	151.00	-0.41	-	-	-845.92	-	-	4.71	1.97

资料来源：wind，华鑫证券研究

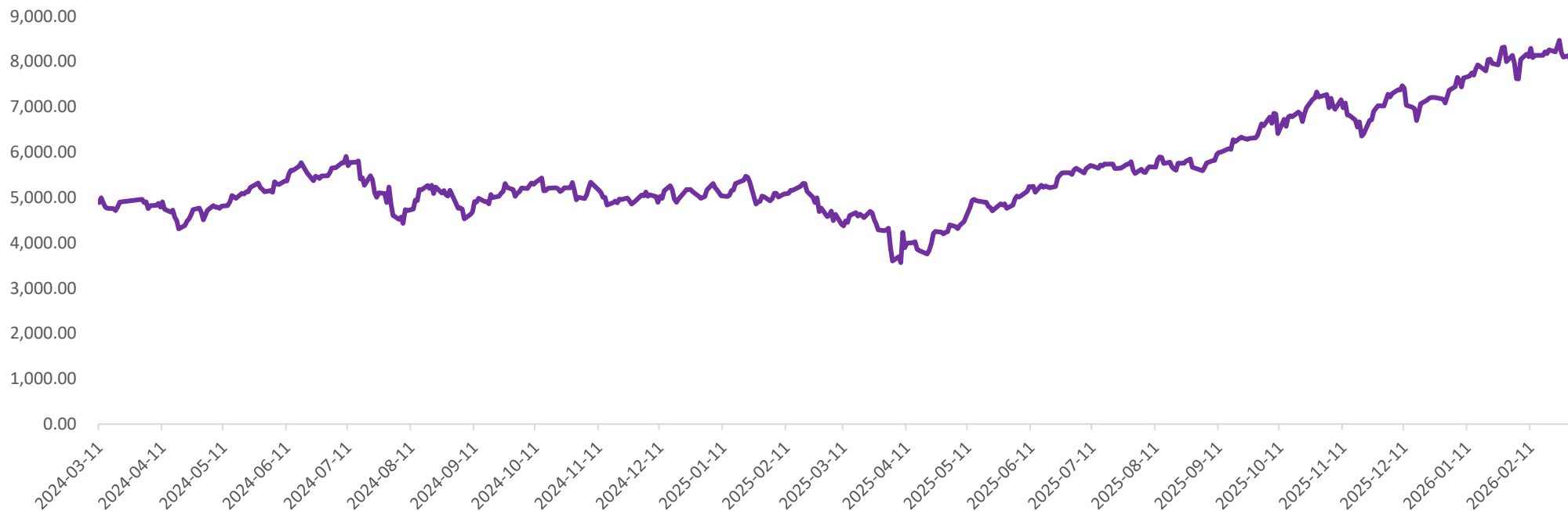
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，3月2日-3月6日当周，费城半导体指数总体呈现震荡下跌的态势，在2026年3月3日出现大幅下跌，近两周整体呈现震荡的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

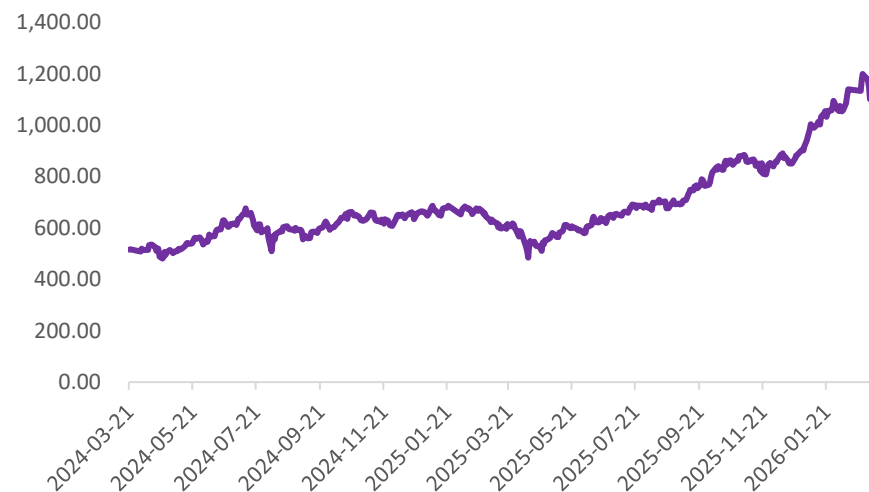


资料来源：wind，华鑫证券研究

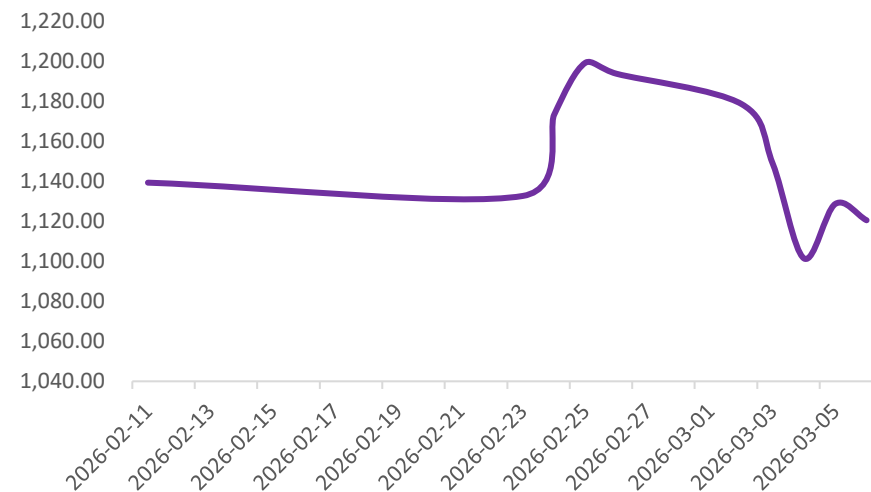
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，2月23日-3月6日两周，台湾半导体行业指数呈现整体下降的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



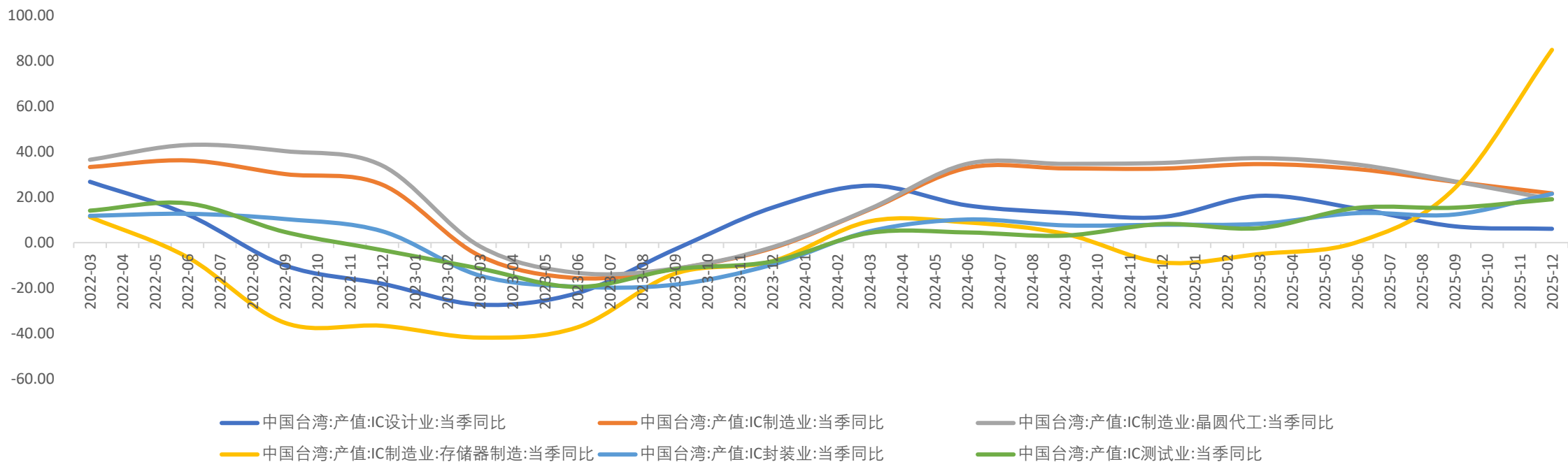
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

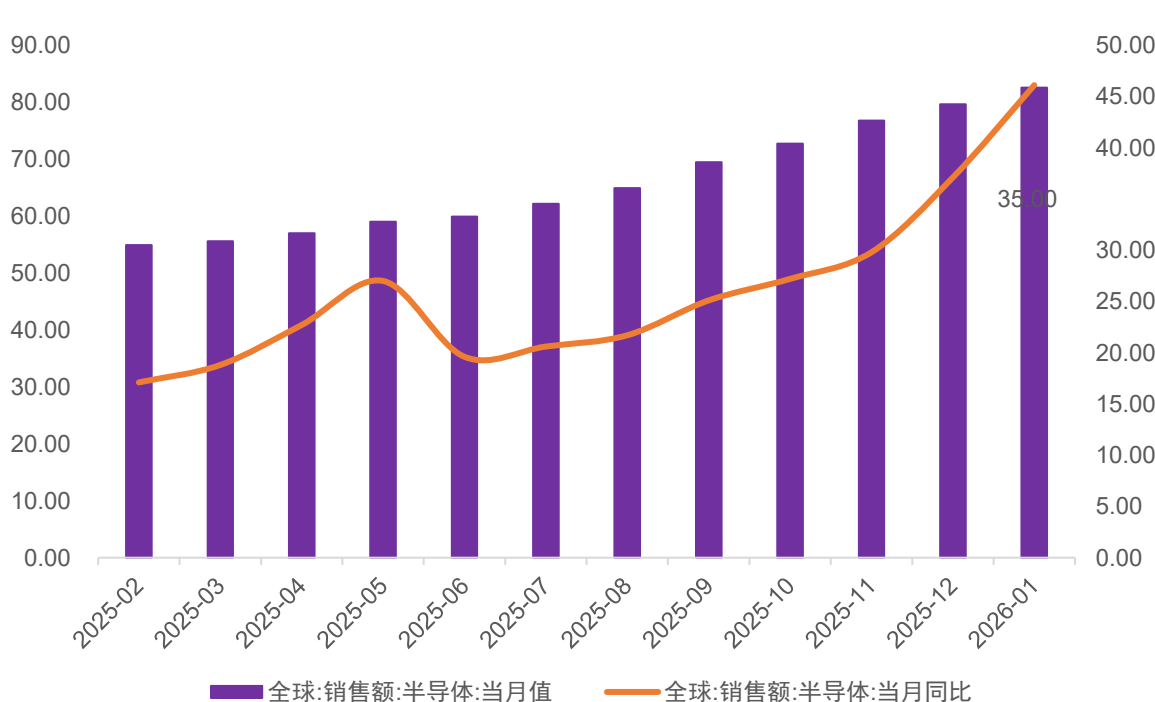


资料来源：wind，华鑫证券研究

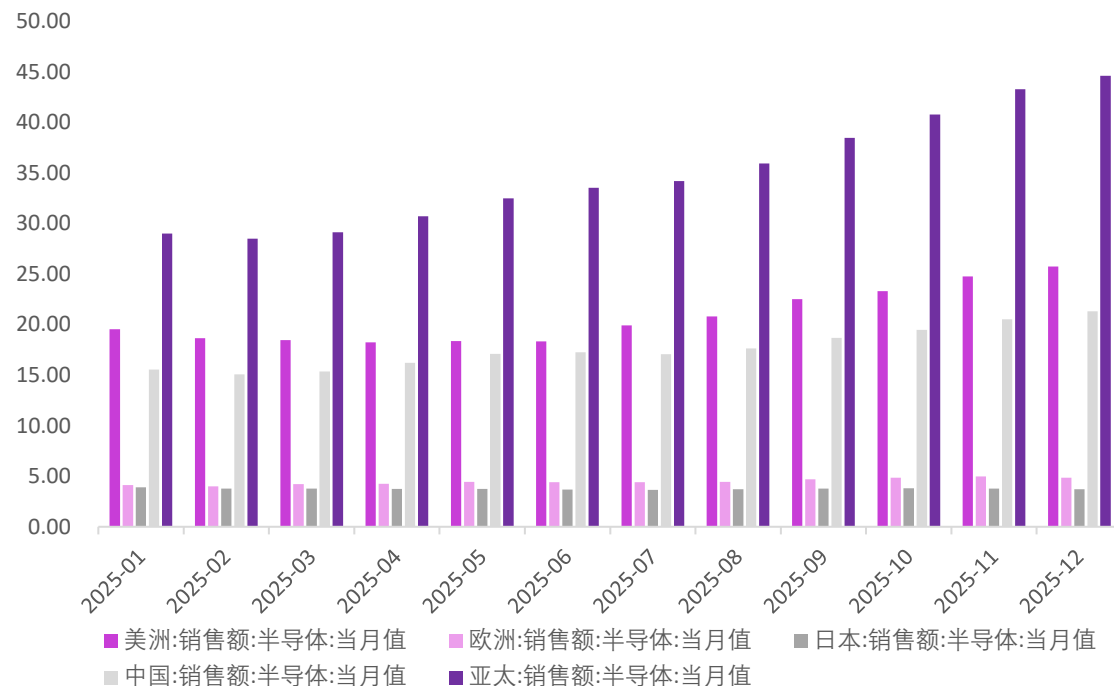
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年1月，全球半导体当月销售额为825.4亿美元，同比增长46.1%。其中，中国销售额为228.2亿美元，环比增长5.75%，占比达27.65%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



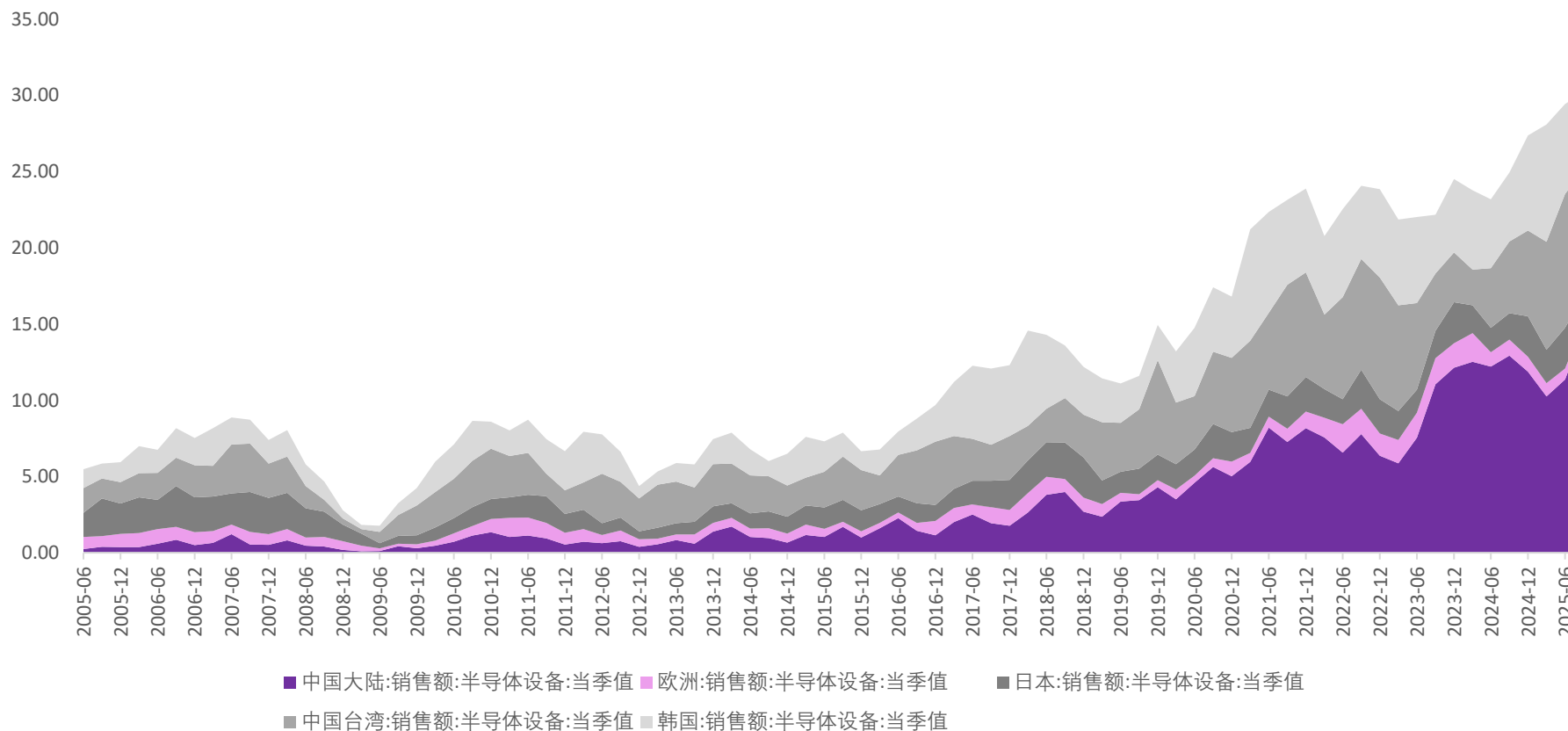
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.5、半导体：全球主要地区的半导体设备当季销售额

2005年以来，全球主要地区的半导体设备当季销售额呈现上升的趋势。2008~2009年，受全球金融危机等因素影响，各地区半导体设备销售额大多出现下滑。2020~2025年，随着5G、人工智能等技术发展带来的半导体需求增加，全球半导体整体呈现增长态势，中国大陆和中国台湾增长较为显著。

2025年三季度，中国大陆半导体设备销售额达到145.6亿美元，同比增长12.61%，环比增长28.17%。

图表14：全球半导体设备销售额（十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

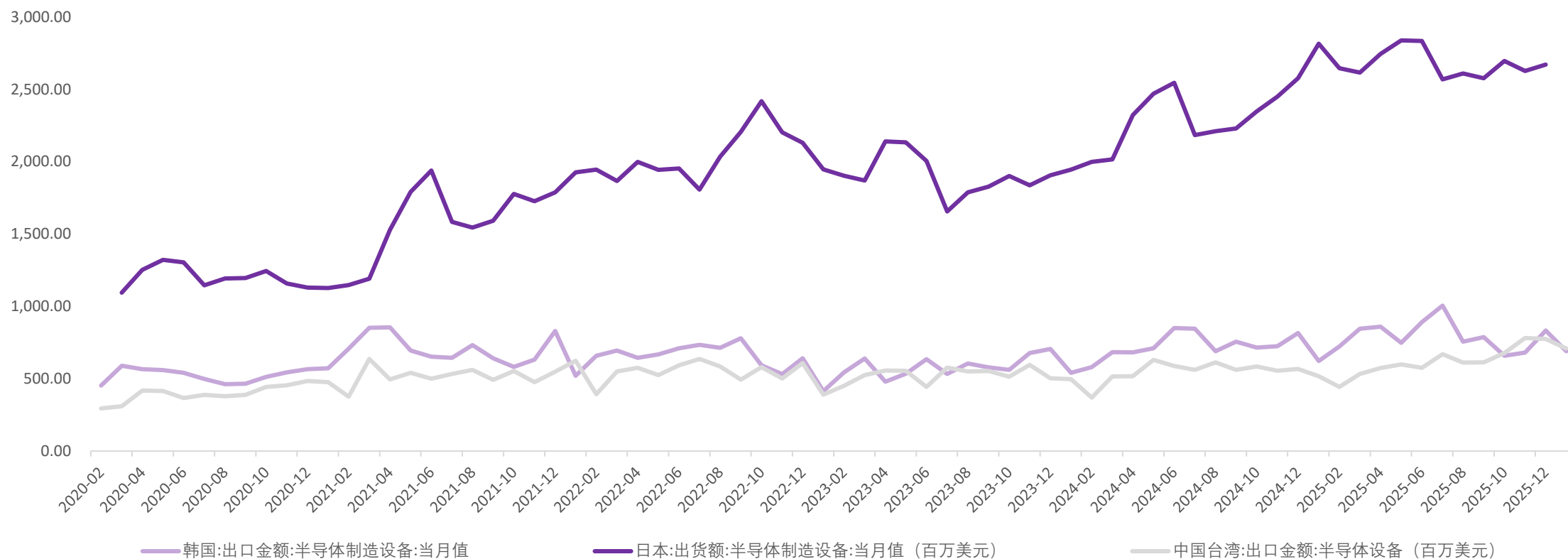


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

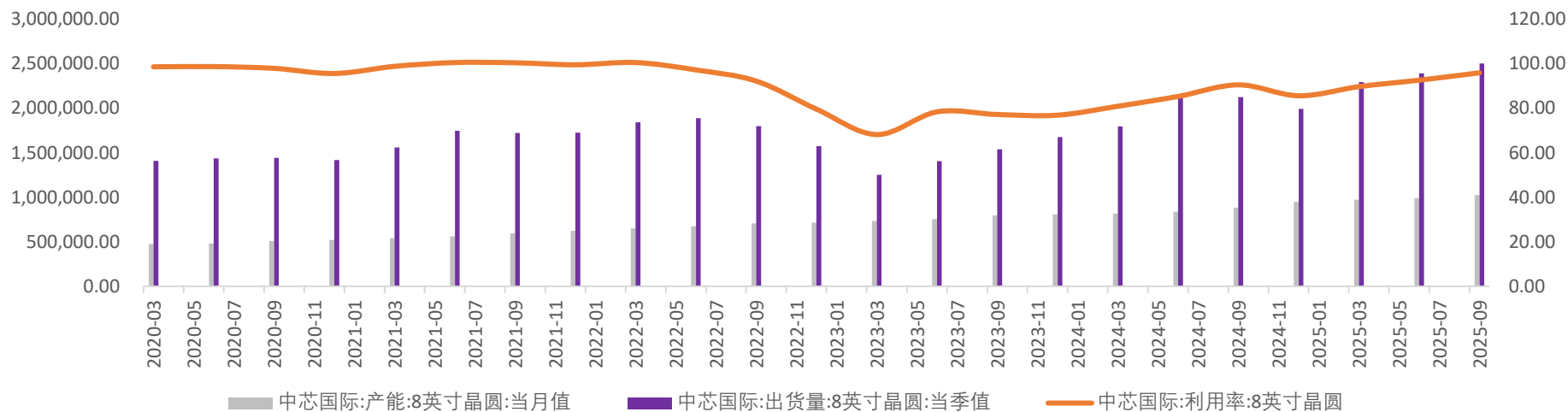
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

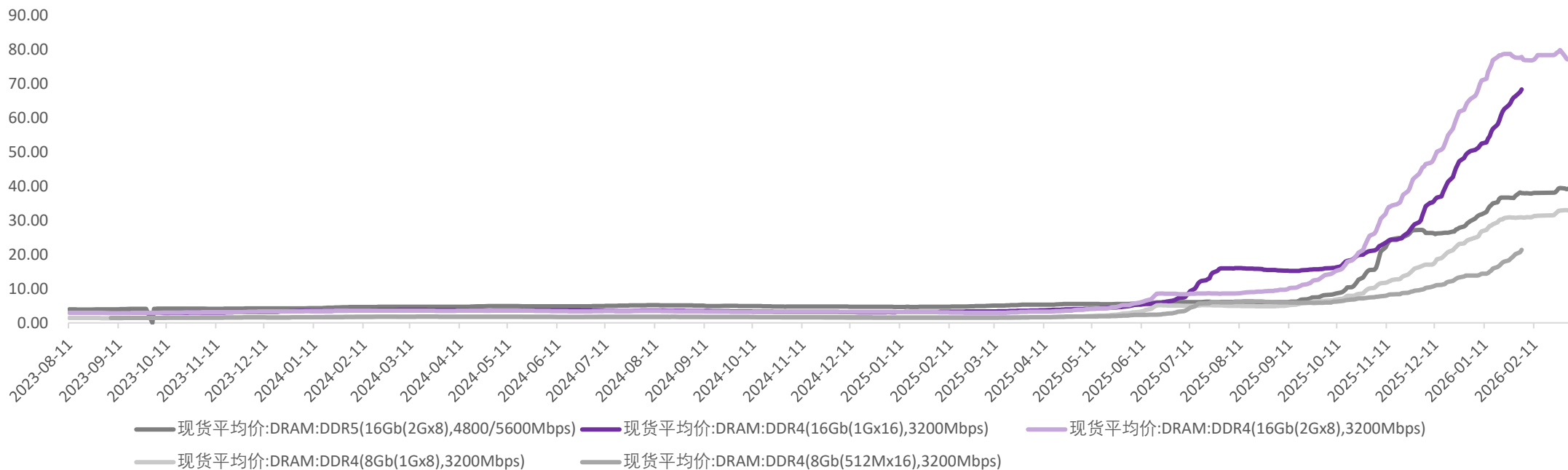


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年2月23日价格为17.95美元。DRAM方面：DRAM:DDR5(16Gb(8Gx2),4800Mbps)现货均价从2024年3月以来价格小幅上涨，9月之后呈现小幅下跌态势，9月之后又重回下跌态势，2025年1月以来呈现大幅上涨的态势，12月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026年3月6日价格为39.67美元。

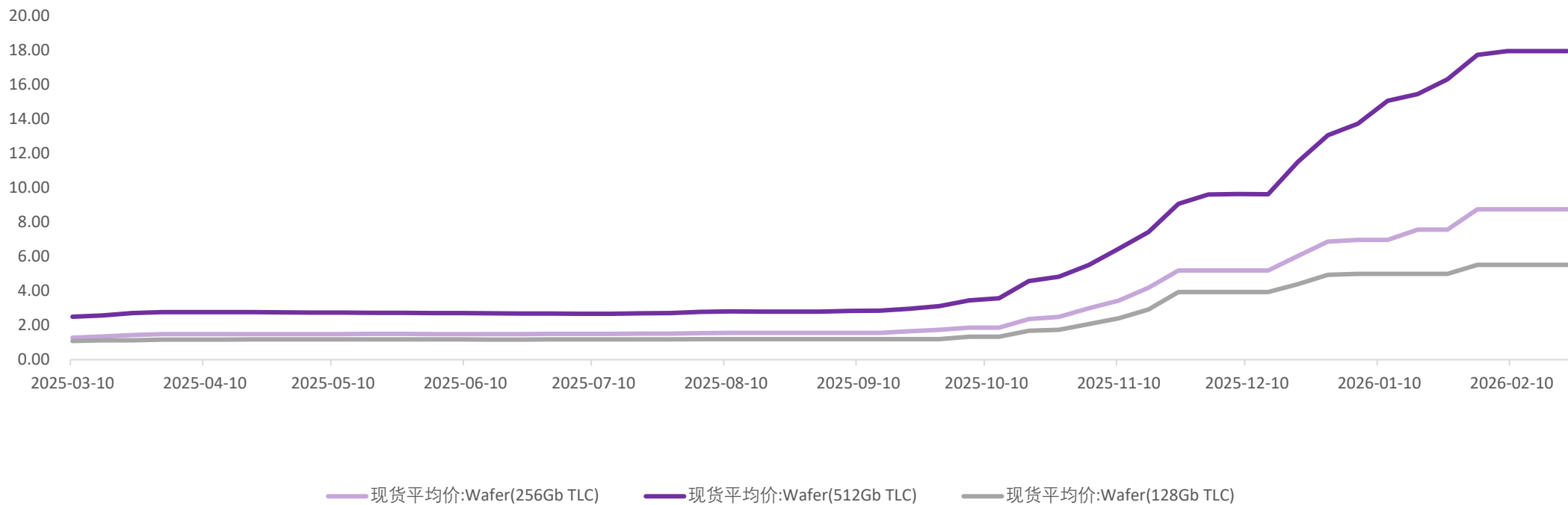
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

■ 苹果M5 Pro/Max发布：首次采用CPU与GPU分离式设计，SoIC-MH封装

近日，苹果公司发布了备受期待的M5 Pro和M5 Max处理器，由苹果最新一代的14英寸和16英寸MacBook Pro机型首发搭载。

根据苹果披露的资料显示，M5 Pro和M5 Max同样采用了台积电3nm家族最先进的N3P架构，并且采用的全新改进的Fusion融合架构，将两颗芯片融合在一起，并采用SoIC-MH先进封装技术，藉此提升芯片整合能力与整体计算效率。

具体来说，M5 Pro 和 M5 Max的CPU核心数量最高均为18核心（M5 Pro有15核心版本），没有配备效率核心，而是采用6个全新的“Super Corres”核心，以及12颗性能核心的组合。

由于新芯片组设计和CPU内核架构上的改进以及制程工艺上的提升，苹果表示，这种配置能提升专业工作负载30%。苹果还表示，结合“Super Corres”核心的多核性能，M5 Pro和M5 Max相比M1 Pro和M1 Max可提升150%。

需要指出的是，M5 Pro和M5 Max的“Super Corres”核心工作频率为4.61GHz，与M5高性能核心采用了相同的频率；M5 Pro和M5 Max的高性能核运行在3.00GHz-4.61GHz范围，M5的效率核则运行在3.00GHz。这也反映了“Super Corres”核心所带来的性能提升，并不是依靠主频提升，而是依靠架构改进。

在GPU方面，M5 Pro为20核心、M5 Max支持最高40核心配置（还有32核心版本）。苹果表示，M5 Pro 的GPU峰值AI计算性能是M4 Pro的4倍，是M1 Pro的6倍；图形性能比M4 Pro高20%；光线追踪性能比M4 Pro高35%。M5 Max 的GPU峰值AI计算性能是M4 Max的4倍，是M1 Max的6倍；图形性能比M4 Max高20%；光线追踪性能比M4 Max高35%。

英特尔Clearwater Forest亮相MWC：18A制程，288核心

3月3日消息，根据Techpowerup报导，英特尔近日于西班牙巴塞罗那召开的MWC 2026展会上，展示了基于Intel 18A制程，代号为Clearwater Forest的新一代Xeon 6+ 服务器处理器，预计2026年正式上市。

据介绍，与上一代处理器相比，Clearwater Forest并不是单纯提升了核心数量，而是采用高度复杂的Chiplet设计，整个封装由12颗Intel 18A制程打造的计算芯粒、3颗Intel 3制程的主动式基础底层芯粒，以及2颗Intel 7制程的I/O芯粒组成。芯粒之间通过Foveros Direct 3D技术进行堆叠整合，同时以EMIB桥接技术串联，形成2.5D与3D混合封装架构。

在CPU架构层面，每颗计算芯粒包含6个模组，每个模组内建4个Darkmont E-core，也就是每颗计算芯粒拥有24个CPU核心，使得单个Clearwater Forest处理器的CPU核心数量达到了288个，因此双插槽系统的核心数量将可达到576核心。

在缓存架构方面，Darkmont E-core采用分组共享设计，每四个CPU核心构成一个集群，共享约4 MB的L2缓存。而在封装层级的整体缓存（LLC）容量已突破1GB，达到约1152 MB。这一层级的缓存配置大幅提升了核心间数据共享的效率，降低了对内存的访问延迟，进一步强化了多核调度与数据密集型任务的性能表现。

平台规格方面，Clearwater Forest延续现有的Xeon服务器插槽，支持12通道DDR5内存，速度目标推进至DDR5-8000，同时提供96条PCIe 5.0通道与64条CXL 2.0通道。

英特尔强调，随着6G网路架构逐步走向虚拟化与云原生，电信营运商倾向将RAN功能与AI推论任务整合于同一颗服务器芯片中。通过在单一SoC上整合矩阵与向量扩充指令、vRAN卸载功能，以及控制面与用户面运算能力，Clearwater Forest可减少独立加速卡的依赖，降低系统复杂度与营运分工隔离风险。一套双插槽系统理论上可建立数十甚至上百个虚拟机（VM），在不突破功耗预算的前提下，提高单机架的工作负载密度。

重磅，美国拟实施AI芯片全球许可制

3月6日消息，根据彭博社的最新报导，美国特朗普政府正考虑推出新的人工智能（AI）芯片出口管制措施，未来企业在出口英伟达与AMD等公司生产的AI芯片时，须先取得美国政府批准。

根据草案内容显示，未来企业在出口美国的AI加速器时，都必须要向美国商务部申请许可，相关的出口目的地限制将由目前约40个国家和地区扩大至全球。特朗普政府表示，此举并非全面禁止芯片出口，而是建立由美国政府审核的许可制度。

在具体规范方面，若企业采购规模不超过1,000颗英伟达的GB300 GPU，将可通过较简化的审查流程；若部署更大型AI芯片集群，则需先取得预先审核并申请出口许可。在部分情况下，企业可能还需要提供商业模式信息或接受数据中心现场查核。

若单一企业在同一国家部署超过20万颗GB300 GPU，则当地政府也需参与审核程序，美国可能仅允许与其具有安全合作关系的盟友国家取得相关芯片。

此外，美国政府还警告称，在全球任何地方使用中国某厂商的AI加速器，都可能违反美国贸易限制。由于目前高端AI芯片主要由美国企业供应，各国在建设AI基础设施时，实际上仍高度依赖美国芯片技术。

目前该政策仍处于讨论阶段，尚未正式定案，未来内容仍可能调整。

2025Q4全球五大NAND厂商营收环比增长23.8%

3月3日消息，根据市场研究机构TrendForce的最新调查显示，2025年第四季全球NAND Flash市场持续受益于人工智能（AI）基础设施建设热潮，前五大NAND Flash品牌厂营收合计环比大幅增长23.8%，达211.7亿美元。尤其北美云服务供应商（CSP）扩建AI基础设施，刺激企业级SSD需求爆发式增长，叠加机械硬盘（HDD）严重缺货、交期过长带来的转单效应，整体NAND Flash缺口更加严重，推升价格涨势，供应商营收规模也因此受益。

从2025年四季度主要NAND Flash厂商的表现来看，排名第一的三星电子营收为66亿美元，环比增长10%，但市占率下滑至28%。产品平均销售价格(ASP)虽明显成长，但位元出货量因前一季基数较高及制程转换损失，呈现环比下滑。

排名第二的是SK集团（包含SK海力士、Solidigm）营收环比大涨47.8%至52.1亿美元，提升市场份额环比增加3.1个百分点至22.1%，位元出货量也因移动NAND Flash和企业级SSD需求增长而增长。

铠侠2025年四季度以33.1亿美元的营收排名第三，环比增长16.5%，营收和位元出货量皆创单季新高，但市场份额环比下滑了1.2个百分点至14.1%。

美光营收则环比增长24.8%至30.25亿美元，排名第四，而这主要得益于其持续提高QLC产出，同时扩大供应采用第九代(G9)NAND Flash的产品。不过，美光的市场份额环比仍略下滑了0.2个百分点至12.8%。

SanDisk营收同样为30.25亿美元，环比增长31.1%，排第五名。受益于整体NAND供应短缺，Sandisk正积极拓展以往较弱的服务器领域，这也使得其数据中心业务出现大幅增长。

展望2026年第一季，由于NAND Flash供需严重失衡，原厂继续拉抬价格的意愿强烈，TrendForce上调第一季整体NAND Flash价格为季增85%~90%，营收水准有望再度成长。

TrendForce指出，2026年在可预见NAND Flash扩产有限、AI需求爆发影响下，价格将维持高涨态势。各大原厂加速技术更新，并转移产品重心至122TB / 245TB等大容量QLC企业级SSD，以因应生成式AI对大容量与传输速度的要求。产能资源也将持续向伺服器端倾斜，消费类产品的供应受到排挤。

单条256GB内存，美光发布全新SOCAMM2模块

2026年3月3日，美光科技（Micron）宣布通过向客户发售业内最大容量LPDRAM模块——256GB SOCAMM2样品，进一步扩大了其在低功耗服务器内存领域的领先地位。这一里程碑得益于业界首个单体32Gb LPDDR5X设计，代表了AI数据中心的变革性进步，提供低功耗内存容量，解锁新的系统架构。

当然，人工智能训练、推理、代理人工智能和通用计算的融合正在推动更高要求的内存需求，并重塑数据中心系统架构。现代AI工作负载驱动大型模型参数、宽广的上下文窗口和持久键值（KV）缓存，而核心计算则在数据强度、并发性和内存占用方面持续扩展。

在这些工作负载中，内存容量、带宽效率、延迟和能效已成为主要的系统级限制，直接影响性能、可扩展性和总拥有成本。LPDRAM独特的这些特性组合使其成为AI和核心计算服务器在日益耗电和热量受限的数据中心环境中的基石解决方案。美光正与英伟达合作，共同设计满足先进人工智能基础设施需求的高端内存。

“美光的256GB SOCAMM2产品，使AI和高性能计算（HPC）都能实现最节能的CPU附加内存解决方案。今日的宣布凸显了美光在技术和封装方面的进步，旨在提供业内最高容量、最低功耗、体积最小的模块化内存解决方案，”美光云存储业务部高级副总裁兼总经理Raj Narasimhan表示。“我们在数据中心应用低功耗内存解决方案方面的持续领先地位，使我们成为首家推出32Gb单片LPDRAM芯片的厂商，助力推动行业采用更节能、大容量系统架构。”

美光现已开始发货其256GB SOCAMM2的客户样品，并提供业内最广泛的数据中心LPDRAM产品组合，涵盖8GB至64GB组件以及48GB至256GB SOCAMM2模块。

三星DRAM合约价Q1涨100%，部分客户已付款锁货

3月4日消息，据韩国媒体ETnews报道三星电子已确认，今年第一季度DRAM合约价格涨幅将超过100%。报道称，今年一月份三星电子谈判的DRAM合约价涨幅达70%，但在后续的一个月内又有所上涨。由于人工智能（AI）普及导致DRAM需求爆炸式增长，导致DRAM价格每个月都在变动。据行业消息显示，三星电子于3月4日与主要客户敲定了第一季度的DRAM供应价格。与上一季度相比，PC和移动设备所用通用DRAM的价格涨幅预计为100%。这意味着DRAM价格较去年第四季度翻了一番。对于部分客户的合约价，部分产品的涨幅已超过100%。一位熟悉此事的行业高管表示：“三星电子已完成DRAM供应价格的谈判，部分海外客户已支付预付款”，并“根据1月至2月间的价格变化，进行了进一步的调整。”值得一提的是，今年2月下旬，韩国媒体Dealsite也曾报道称，三星电子半导体部门成功将苹果iPhone所需的LPDDR5X内存合约价格提高了100%。这甚至使得三星半导体部门不愿降价向三星手机部门供应DRAM芯片，并缩减了供应量。尽管DRAM价格在大幅上涨，但想要购买的客户依然排起了长龙。此前的报道显示，众多的全球大型科技公司的采购负责人都来到了韩国，并联系了三星电子、SK海力士等存储器制造商，以提前确保供应。三星电子持续与客户协商价格，并考虑供应能力。分析显示，即使在供应谈判期间，需求也仍在持续激增，这也推动了1月后DRAM价格进一步上涨。过去DRAM长期供应合同通常是每年签订。但自去年下半年以来，由于供应短缺，DRAM制造商开始签订季度合约，并随着价格快速变化，甚至开始不再接受长合约，而是按月签订合约，以即使反映市场价格涨幅。三星电子并不是唯一一家持续推高DRAM价格的公司。业内预计SK海力士和美光在第一季度的供应合同中签订的价格涨幅比例与其相近。

英特尔CFO：18A制程将获外部客户采用

当地时间3月4日，英特尔首席财务官David Zinsner在旧金山举行的摩根士丹利（Morgan Stanley）的会议上表示，Intel 18A制程已经达到了公司预期，随着产线逐步成熟，良率持续稳定提升，预期Intel 18A系列制程（包含Intel 18A-P等衍生版本）将获得客户采用。目前，苹果与英伟达都在评估。

在英特尔CEO陈立武的领导英特尔正积极开拓晶圆代工业务。特别是在AI热潮、美国关税政策及特朗普政府力推芯片本地制造的背景之下，英特尔的晶圆代工业务正迎来新的发展机遇。

David Zinsner也表示，Panther Lake产品的市场反应非常好，尤其是在电池续航表现方面，目前市场的需求其实高于供应能力，而这种供不应求情况也有助于提升公司毛利率。虽然目前Intel 18A在晶圆厂仍处于早期的量产阶段，但随着今年的持续推进，到了明年毛利率将会持续改善。

市场最初认为Intel 18A系列不会作为提供给外部代工客户的主要制程，英特尔将把接下来的Intel 14A定位为 主要提供给外部客户的制程。不过David Zinsner表示，客户对Intel 18A-P也展现兴趣。因为该制程允许客户依据功耗等需求进行定制化调整，市场普遍预期苹果可能成为主要客户之一，并用于未来M系列SoC。

至于Intel 14A制程，David Zinsner重申，英特尔仍按照原始蓝图推进，2027年进行风险试产、2029年正式量产。英特尔在14A投资策略上仍保持谨慎，会先观察客户合作情况与内部需求，再决定是否投入更多资本支出建设产线。

David Zinsner表示，目前客户接洽情况不错，因此对Intel 14A制程持审慎乐观态度，而英特尔内部本身也对14A有需求。他强调，英特尔原本就规画2028年试产、2029年量产，但从内部需求看，其实有能力在2027年就开始风险试产，如果客户希望在同一时间点进行试产，公司也能配合。风险试产其实仍然可以产出具有实际用途的芯片。

斥资9000万美元，联发科入股硅光芯片大厂Ayar Labs

3月2日消息，据台媒报道，联发科近日通过子公司Digimoc Holdings Limited以每股52.24 美元的价格，取得美国硅光子厂商Ayar Labs特别股1,722,759股，交易总金额约9,000万美元，持股比例约2.4%。业界认为，随着AI服务器逐步转向光学传输，联发科可通过此次投资，强化在光学传输领域的布局。

资料显示，Ayar Labs 是一家专注于硅光子（silicon photonics）和光互连技术的美国高科技公司，总部位于加利福尼亚州圣何塞（San Jose）。该公司致力于通过光学 I/O（输入/输出）彻底改变数据中心、人工智能（AI）、高性能计算（HPC）等领域的数据传输方式，以解决传统铜线互连在带宽、功耗和延迟方面的瓶颈问题。

Ayar Labs 的核心技术基于硅光子集成电路，将光信号用于芯片内及芯片间的数据传输，从而实现比传统电信号互连更高的带宽、更低的延迟以及更优的能效。其旗舰产品包括：TeraPHY™ 光学 I/O 芯片和 SuperNova™ 多波长远程光源，旨在最大限度地提高数据传输和计算效率，同时降低成本、延迟和功耗。这些产品符合开放行业标准（如 UCle），可以与现有的 CPU、GPU、FPGA 等加速器无缝集成，有助于实现更高效的 AI 基础设施设计。

自 2015 年成立以来，Ayar Labs 获得了来自多个行业领军企业的投资和战略合作支持，包括 NVIDIA、Intel、AMD Ventures、GlobalFoundries、Hewlett Packard Enterprise (HPE)、Lockheed Martin Ventures 等。最新一轮的D轮融资为 1.55 亿美元，公司估值已超过 10 亿美元。

Ayar Labs于2025年开设中国台湾新竹办公室，并与特殊应用芯片设计厂商创意及世芯-KY建立战略合作伙伴关系。同时，Ayar Labs 也与创意合作，并获得台积电青睐，通过子公司VentureTech Alliance 注资，也显示Ayar Labs 在全球光学传输的关键地位。

全球首条，上海35微米功率半导体超薄晶圆工艺及封装测试线建成

据上海松江消息，位于松江综保区的尼西半导体科技（上海）有限公司，已经建成全球首条35微米功率半导体超薄晶圆工艺及封装测试生产线。这一厚度突破让功率芯片的导通电阻和热阻大幅降低，显著提升了器件的能效与散热性能，为新能源汽车、5G基站等高功率密度应用场景提供了核心支撑，为国产器件进入高压平台、快充等市场提供了量产底座。

晶圆越薄，性能越好，但加工难度也直线上升。因为晶圆薄到50微米以下后，脆得像薯片，稍微受力就可能裂开。

据介绍，在加工工艺方面，尼西半导体将晶圆加工精度控制在 35 ± 1.5 微米，并通过化学腐蚀技术消除92%的研磨应力损伤，使极薄晶圆的碎片率降至0.1%以内。切割环节采用定制化激光技术替代传统刀片，热影响区显著缩小，切割良率达到98.5%。

设备参数显示，产线研磨机加工精度达0.1微米，片内厚度偏差小于2微米；激光切割机切缝宽度仅11微米，相较传统工艺可提升约10%的芯片有效面积利用率。

芯片做薄了，好处直接体现在电和热上。载流子跑通芯片的时间缩短40%，发热量下降，导通损耗就少了。热阻比100微米的标准品下降60%，相当于给芯片装上了更好的散热片。封装环节也跟着受益——可以做双面散热，模块热阻再降30%，功率循环寿命翻了5倍。

而应用端测算表明，同等晶圆面积下芯片产出量增加20%，可使手机快充模块体积缩减一半，并为电动汽车电控单元减重3公斤。

目前，该产线测试环节单日产能可达12万颗成品，键合机单日产能约400片。产线中的键合、研磨、切割及解键合等核心装备，均由尼西半导体与国内设备厂商联合研发，在协同创新中实现了关键设备的自主可控，填补了国内相关制造领域的应用空白。

04 公 司 公 告

研究创造价值

■ 华天科技:2-1 天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）

根据天水华天科技股份有限公司发布的公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方持有的华羿微电子股份有限公司100%股权，交易价格为299,600万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易标的公司华羿微电主要从事高性能功率器件的研发、设计、封装测试及销售，属于半导体分立器件制造行业。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。

公司表示，通过本次交易将进一步优化产业布局，提升公司核心竞争力和盈利能力。

卓胜微:2025年度业绩快报

根据江苏卓胜微电子股份有限公司发布的公告，2025年公司实现营业总收入372,609.46万元，同比下降16.96%；营业利润-31,312.54万元，同比下降186.00%；归属于上市公司股东的净利润-26,801.88万元，同比下降166.70%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-31,815.25万元，同比下降187.51%。截至报告期末，公司总资产1,546,370.74万元，较期初增长8.65%；归属于上市公司股东的所有者权益989,714.06万元，较期初下降2.96%。

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益等指标同比降幅较大，主要系公司在向Fab-Lite模式转型过程中持续加大能力建设投入，同时受行业竞争激烈、部分原材料产品交付环节紧张及下游客户库存结构优化调整等因素影响，导致营业收入及毛利率较上年同期有所下降。公司表示，目前各工艺进展顺利并按规划节点推进，已储备面向高端射频、卫星通信及光通信等领域的基础工艺技术，并将持续推进芯卓平台能力建设及高端工艺市场布局。

力芯微:2026年限制性股票激励计划（草案）

根据无锡力芯微电子股份有限公司发布的公告，公司拟实施2026年限制性股票激励计划，激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。本次激励计划拟授予限制性股票113.2万股，约占草案公告时公司股本总额13,369.27万股的0.85%。其中首次授予93.2万股，占授予权益总额的82.33%；预留20万股，占授予权益总额的17.67%。限制性股票授予价格为26.70元/股。

本激励计划首次授予的激励对象共115人，占公司员工总数593人的19.39%，主要包括核心技术人员及技术（业务）骨干人员。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。首次授予的限制性股票将分三期归属，归属比例分别为30%、30%和40%，并以营业收入增长率作为公司层面业绩考核指标。

大为股份:2025年年度报告

根据深圳市大为创新科技股份有限公司发布的2025年年度报告，报告期内公司实现营业收入1,222,356,156.91元，同比增长16.74%；归属于上市公司股东的净利润为-15,621,781.98元，上年同期为-48,407,047.08元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-9,370,737.06元。报告期末，公司总资产为706,989,629.39元，归属于上市公司股东的净资产为544,530,224.02元。

报告期内，公司围绕半导体存储、新能源等领域开展业务布局，其中半导体存储业务主要通过全资子公司大为创芯开展，产品包括DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR4X等DRAM产品以及eMMC、BGA NAND Flash、UFS等NAND Flash产品，广泛应用于智能电视、网络通讯、平板电脑、个人电脑、车载及工业控制等领域。报告期内半导体存储业务收入为1,097,818,349.56元，占营业收入比重为89.81%。

帝奥微:关于出售参股公司股权的公告

根据江苏帝奥微电子股份有限公司发布的公告，公司拟与杭州云控半导体有限公司签订《股权收购协议》，由杭州云控以人民币4,571.3973万元受让公司持有的江苏云途半导体有限公司17.3262万元注册资本对应的1.9388%股权。本次交易价格经双方友好协商确定，截至2025年12月31日，公司持有该部分股权的账面成本为4,000万元，交易价格较账面值溢价14.28%。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

本次交易标的为公司持有的江苏云途1.9388%股权。江苏云途成立于2020年7月，主营业务包括集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片设计及服务等。公司表示，本次交易有利于整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，同时增加运营资金，更加聚焦公司主业并持续提升核心竞争力。本次交易对方具备履约能力，但仍存在履约风险及交易实施不确定性的风险。

德明利:深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)

根据深圳市德明利技术股份有限公司发布的公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于PCIe SSD主控芯片研发及产业化项目、嵌入式存储主控芯片研发及产业化项目、企业级存储主控芯片研发项目以及补充流动资金。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。公司表示，本次募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司在存储主控芯片领域的研发能力和产业化能力，增强核心竞争力并促进公司持续发展。

源杰科技:关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

根据陕西源杰半导体科技股份有限公司发布的公告，公司于2026年3月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案。公司拟在境外发行H股股票，并申请在香港联合交易所有限公司主板上市。公司表示，本次H股上市旨在持续推进公司国际化战略及全球化布局，搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力。

公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次H股上市。本次发行H股并上市尚需履行股东会审议，并需要根据取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的批准、核准或备案。本次H股上市的具体细节尚未最终确定，相关事项仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4年投研经验。2023年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值